

Bitte
frei
machen

Fraunhofer IPK
Claudia Engel
Pascalstr. 8-9
10587 Berlin

MEHR KÖNNEN

ANTWORT

Bitte Rückseite ausgefüllt zurücksenden oder
per Fax an +49 30 39006-392 schicken.

INFORMATIONEN

Veranstaltungsort

Online, MS Teams

Eine Veranstaltung für

Werkzeugmaschinenhersteller und -zulieferer, Anwender
von Werkzeugmaschinen sowie Fach- und Führungskräfte
aus der Fertigung, Entwicklung und Konstruktion

Teilnehmerbeitrag

50,- € bis zum 14. Februar 2021, danach 100,- €
Jede*r weitere Teilnehmende aus einer Firma: 50,- €

Fachliche Ansprechpartner

Dr.-Ing. Mitchel Polte

Tel. +49 30 39006-434

mitchel.polte@iwf.tu-berlin.de

Florian Triebel

Tel. +49 30 314-24450

florian.triebel@iwf.tu-berlin.de

www.berliner-runde.info

Anmeldungen

Claudia Engel

Tel. +49 30 39006-238

weiterbildung@ipk.fraunhofer.de

www.ipk.fraunhofer.de/weiterbildung

© Foto: Dmitry Kalinovsky

MEHR KÖNNEN

VERANSTALTUNGEN 2021

Dem wachsenden Bedarf an beruflicher Weiterbildung gerecht zu werden und den Wissenstransfer aus der Forschung in die Industrie noch intensiver zu fördern, das ist das Ziel des Veranstaltungsprogramms »Mehr Können« des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK. Auf unseren Tagungen und Konferenzen, Technologietagen, Industriearbeitskreisen, Seminaren und Workshops bieten wir Ihnen praktisch anwendbares Wissen über topaktuelle Technologien und Verfahren für das Management, die Produktentstehung, den Produktionsprozess und die Gestaltung moderner Fabrikbetriebe.

Gehen Sie weiter – wissenschaftlich fundiertes, praxisnahes Know-how bringt Sie voran.

Unsere Veranstaltungen bieten mehr als theoretische Wissensvermittlung. Hier können Sie Technologien und Methoden selbst ausprobieren und erhalten aus erster Hand Beispiele für ihre erfolgreiche Anwendung. Zudem stellen wir höchste Ansprüche an die Qualität unserer Inhalte und ihrer Vermittlung: Das Fraunhofer IPK ist durch die DQS nach der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert. Mehr über unser Angebot erfahren Sie unter www.ipk.fraunhofer.de/weiterbildung

15. Berliner Runde Neue Konzepte für Werkzeugmaschinen

TAGUNG

18. März 2021



IN KOOPERATION MIT

IWF

INSTITUT
WERKZEUGMASCHINEN UND FABRIKBETRIEB
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN

 **BERLINER
RUNDE** 2021

15. Berliner Runde

Neue Konzepte für Werkzeugmaschinen

TAGUNG

Leistung, Hochleistung, Höchstleistung – Was bringt die Zukunft?

Um dem Konkurrenzdruck durch eine verkürzte Time-to-Market bei kurzen Produktlebenszyklen standzuhalten, ist eine stetige Erhöhung der Produktivität von Bearbeitungssystemen notwendig. In ihrer 15. Auflage rückt die Berliner Runde – das führende Forum für Werkzeugmaschinenhersteller, Zulieferer und Anwender – deshalb die Potenziale und Herausforderungen der Hochleistungsbearbeitung in den Mittelpunkt. Themen sind unter anderem die Erschließung neuer Werkzeuge und Bearbeitungsstrategien sowie die Entwicklung hybrider Bearbeitungssysteme mit höchster dynamischer Leistungsfähigkeit und integrierter Sensorik. Diese erlauben höchste Genauigkeiten bis in den Nanometerbereich, was insbesondere bei der Herstellung optischer Systeme von großer Relevanz ist. Die am Prozess beteiligten Komponenten werden durch die stark erhöhten Anforderungen an ihren Leistungsgrenzen betrieben, weshalb sicherheitsrelevante Themen zusätzlich fokussiert werden.

Hochrangige Referentinnen und Referenten aus dem Werkzeugmaschinenbau, der Komponentenherstellung und der Anwendung stellen aktuelle und zukünftige Entwicklungen der Werkzeugmaschinenbranche vor. Diskutieren Sie mit uns, welche System- und Komponentenlösungen neue Impulse für die Hochleistungsbearbeitung setzen können und welche sicherheitsrelevanten Konsequenzen daraus resultieren.

PROGRAMM

Donnerstag, 18. März 2021

08.00 Öffnung der virtuellen Konferenzumgebung

08.30 Begrüßung

Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann,
IWF TU Berlin, Fraunhofer IPK

Keynote: Leistung, Hochleistung, Höchstleistung – was bringt die Zukunft?

Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann,
IWF TU Berlin, Fraunhofer IPK

Keynote: Produktion der Zukunft –

Nutzung von Daten aus der Werkzeugmaschine

Dr.-Ing. Thomas Mücke, Siemens Industries Software GmbH

09.40 Pause

10.00 Laserbasierte DED- und LPBF-Technologie für die additive Fertigung hochleistungsfähiger Produkte

Hannes Freisse, AddUp Group (BeAM)

Steigerung der Flexibilität und Wirtschaftlichkeit

durch die Kombination von Fräs- und Schleifbearbeitung

Dr.-Ing. Oliver Gossel, Röders GmbH

Optimal vorbereitet

Matthias Funk, Hedelius GmbH

11.00 Projektvorstellung IWF und IPK

11.20 Pause

11.30 Die intelligente Werkzeugaufnahme zur Prozessüberwachung und -steuerung

Thomas Wittkowski und Moritz Wiedmann,
SCHUNK GmbH & Co. KG

Digitale Effizienz in der Einzelteilfertigung

Benjamin Körber und Frank Wunder,
Körber & Körber GmbH Präzisionsmechanik

12.10 Projektvorstellung IWF und IPK

12.30 Mittagspause

13.30 Maschinen- und Spindelschutz sowie andere smarte Helfer zur Sicherung der Produktivität

Andreas Richter, GF Machining Solutions GmbH

Herausforderungen und Möglichkeiten

sensorbasierter Zerspanung in Bezug auf innovative Maschinenkonzepte von heute und morgen

Lennart Riehle, pro-micron GmbH

14.10 Projektvorstellung IWF und IPK

14.30 Pause

14.40 Sicherheit an Werkzeugmaschinen im Einfluss der Gesetzgebung und Normung

Christian Adler, Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Schutzscheiben für Werkzeugmaschinen der Hochleistungsbearbeitung

Sonad Taner, BSA Kunststofftechnik GmbH

15.20 Schlusswort und Feedback

ANMELDUNG

- Ja**, ich möchte an der Berliner Runde
am 18. März 2021 zum Beitrag von 50,- € bis zum
14. Februar 2021, danach 100,- € teilnehmen.

Name *	Vorname *	Titel
Firma / Institut *		
Position / Abteilung		
Straße / Postfach *		
PLZ / Ort *		
USt-IdNr. (außer Privatpersonen oder Unternehmen ohne USt-IdNr.)*		
Buchungsnummer, falls erforderlich		
Rechnungsadresse, falls abweichend		
Rechnungs-E-Mail-Adresse, falls abweichend		
Telefon *	Fax	
E-Mail *	* Daten erforderlich	
Datum, Unterschrift		

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten vom Veranstalter elektronisch gespeichert und im Teilnehmerverzeichnis der Veranstaltung abgedruckt werden. Meine personenbezogenen Daten werden darüber hinaus vertraulich behandelt und im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausschließlich zur Veranstaltungsorganisation des Fraunhofer IPK sowie zur zukünftigen Information über Veranstaltungen des Instituts genutzt. Ich habe das Recht, meine Einwilligung zur Speicherung und Nutzung meiner Daten jederzeit zu widerrufen und der Zusendung von Informationsmaterial zu widersprechen.

